****

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросы читателей:** | **Контакты для прессы:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Системная плата форм-фактора Thin Mini-ITX компании congatec с впаянным процессором Intel® Core™ шестого поколения, предоставляет широчайшие возможности масштабируемости и позволяет использовать быструю DDR4 память.*

*Текст и фото доступны на сайте:* <http://www.congatec.com/press>

Пресс релиз от

**Индустриальная системная плата форм-фактора Thin Mini-ITX от Сongatec со встроенным процессором Intel® Core™6-го поколения**

*Высокая масштабируемость для самого широкого круга индустриальных приложений*

**Германия, Дегендорф, 2016 года.** Компания congatec, лидирующая компания в области встраиваемых компьютерных модулей, одноплатных компьютеров SBC (англ. SBC - single board computer), разработки и производства встраиваемых решений EDM (англ. EDM - embedded design and manufacturing), представила широко масштабируемые системные платы форм-фактора Thin Mini-ITX с впаянным процессором Intel®. Новые платы в представленных конфигурациях, выделяются использованием различных процессоров, начиная от 2,0 ГГц Intel® Celeron® и вплоть до Intel® Core™ i7 работающих на частоте до 3,4 ГГц. Системные платы индустриального исполнения так же предлагают тепловыделение TDP (англ. TDP - thermal design power, конструктивные требования по теплоотводу) в регулируемом диапазоне от 15 Вт до 7,5 Вт, поддержку до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, а так же поддержку нескольких мониторов с разрешением 4К. Наряду с данными преимуществами, платы так же обладают широчайшими возможностями подключения внешней периферии, такой как SIM-карты, недорогие CMOS камеры, валидаторы купюр и устройства работы с кредитными картами. Так же к плюсам можно отнести длительный срок присутствия на рынке - от 7 лет, и индустриальный дизайн платы, обеспечивающий ее безотказную работу в жестких условиях эксплуатации. Для производителей оригинального оборудование (OEM) это предложение дает дополнительные преимущества в виде сокращения сроков разработки и делает более экономически эффективным общий процесс разработки продукта.

Благодаря таким выдающимся возможностям масштабируемости, новые системные платы форм-фактора Thin Mini-ITX conga-IC170 идеально подходят для самого широкого спектра индустриальных приложений. Сфера использования данных плат лежит в широком диапазоне различных применений, начиная от терминалов человеко-машинного интерфейса (HMI) с пассивным охлаждением, управляющих и SCADA-систем, мощных и надежных торговых терминалов самообслуживания, и заканчивая игровыми автоматами и интерактивными указателями. Дизайн Thin Mini-ITX плат с толщиной всего 20 мм, позволяет использовать их для проектирования очень тонких пультов управления и индустриальных компьютеров типа «все-в-одном» (англ. «All-in-One PC»). Опциональная возможность поддержки стандарта Smart Battery, еще более расширяет сферу применения данных плат, позволяя использовать их в портативных устройствах с батарейным питанием, таких как, например, ультразвуковые системы диагностирования для медицинской сферы. Наличие встроенного контроллер работы платы BMC (англ. BMC - Baseboard management controller, технологии удаленного управления сервером) и поддержка технологии Intel® vPro™ в сочетании с Intel® AMT (англ. AMT - Active Management Technology, аппаратная технология, предоставляющая удаленный, и внеполосный (по независимому вспомогательному каналу TCP/IP) доступ для управления настройками и безопасностью компьютера независимо от состояния питания (удаленное включение / выключение компьютера) и состояния ОС), значительно повышают надежность работы распределенных систем категории «Интернета вещей» (англ. IoT – Internet of Things), и во многих случаях помогают решить вопросы поддержки работоспособности без непосредственного выезда на место.

**Детальнее о возможностях новой системной платы**

Системная платы форм-фактора Thin Mini-ITX conga-IC170 выпускается с предустановленной двухядерной версией SoC U-серии, процессоров Intel® Core™ 6-го поколения. Линейка предустановленных процессоров представлена процессором начального уровня Intel® Celeron® 3995U с частотой 2,0 ГГц, после которого следуют процессоры Intel® Core™ i3 6100U (2.3ГГц) и i5 6300U (2.4ГГц, 3ГГц в режиме Turbo Boost), вплоть до Intel® Core™ i7 6600 с максимальной частотой 3,4 ГГц в режиме Turbo Boost. В зависимости от установленного процессора, новые платы предлагают управляемое тепловыделение (TDP) в диапазоне от 15 Вт до 7,5 Вт, что позволяет легко интегрировать плату в общую концепцию энергопотребления разрабатываемого приложения. Два разъема SO-DIMM поддерживают память с объемом до 32 Гб стандарта DDR4-2133, который обеспечивает значительно более широкую пропускную способность и улучшенное энергопотребление по сравнению c реализациями подсистемы памяти, которые основаны на стандарте DDR3. Встроенная графическая подсистема Intel® Gen9 поддерживает стандарт DirectX и OpenGL 4.4 для высокопроизводительных 3D задач, и позволяет отображать информацию на 3-х независимых экранах с разрешением 4К (3840х1260) и частотой 60 Гц, используя 2 порта DP++ и 1 порт eDP, в сочетании с возможностью задействования двухканального 24-битного LVDS. Так же поддерживается аппаратное ускорение видео стандартов HEVC, VP8, VP9 и VDENC.

Вдобавок к слоту PCIe x4 (Gen 3), обширный набор разъемов так же включает в себя 1х mPCIe с поддержкой стандарта M.2, который может так же быть использован для дополнительных карт расширений или же подключения SSD-диска. Подключение дополнительной периферии возможно благодаря наличию 4-x USB 3.0 и 6-ти USB 2.0 портов; 2 порта Gigabit Ethernet и слот для SIM-карт позволяет использовать плату для полноценных M2M приложений; интерфейс MIPI CSI-2 позволяет непосредственно к плате подключать недорогие CMOS камеры. Для индустриального применения так же имеется 2 COM порта, один из которых может быть сконфигурирован как ccTalk, и 8 линий GPIO. Опционально так же предлагается поддержка встроенного криптопроцессора Trusted Platform Module. Для подключения жестких дисков могут быть использованы 2 разъема SATA 3.0. Для подключения аудио устройств предназначены цифровой порт и порт HD Audio для подключения 5.1-канального звука. В качестве операционной системы могут использоваться все актуальные версии Linux и Windows, включая Windows 10. В продаже так же представлен широкий ассортимент аксессуаров, таких как системы охлаждения, внешние панели ввода/вывода и различны кабели.

*Для получения дополнительной информации о системной плате форм-фактора Thin Mini-ITX conga-IC170 обращайтесь на сайт по адресу:*

<http://www.congatec.com/en/products/mini-itx/conga-ic170.html>

**About congatec AG**Headquartered in Deggendorf, Germany, congatec AG is a leading supplier of industrial computer modules using the standard form factors Qseven, COM Express, XTX and ETX, as well as single board computers and EDM services. congatec’s products can be used in a variety of industries and applications, such as industrial automation, medical, entertainment, transportation, telecommunication, test & measurement and point-of-sale. Core knowledge and technical know-how includes unique extended BIOS features as well as comprehensive driver and board support packages. Following the design-in phase, customers are given support via extensive product lifecycle management. The company’s products are manufactured by specialist service providers in accordance with modern quality standards. Currently congatec has entities in Taiwan, Japan, China, USA, Australia and the Czech Republic. More information is available on our website at [www.congatec.com](http://www.congatec.com) or via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel and Intel Core and Celeron are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*